



## 平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年10月26日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社テラプローブ

コード番号 6627 URL <http://www.teraprobe.com/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 渡辺 雄一郎

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員CFO

(氏名) 神戸 一仁

TEL 045-476-5711

四半期報告書提出予定日 平成23年11月14日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成24年3月期第2四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年9月30日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第2四半期	11,279	10.3	1,848	△23.4	1,683	△25.5	974	△39.1
23年3月期第2四半期	10,224	—	2,414	—	2,259	—	1,601	—

(注) 包括利益 24年3月期第2四半期 684百万円 (△55.8%) 23年3月期第2四半期 1,549百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第2四半期	105.01	—
23年3月期第2四半期	208.47	—

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第2四半期	47,424	27,241	54.1
23年3月期	50,325	26,557	49.5

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 25,672百万円 23年3月期 24,893百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	0.00	—	0.00	0.00
24年3月期	—	0.00	—	—	—
24年3月期(予想)	—	—	—	10.00	10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

### 3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	25,300	18.3	2,900	△44.0	2,500	△48.3	1,400	△66.3	150.82

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

#### 4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

24年3月期2Q	9,282,500 株	23年3月期	9,282,500 株
----------	-------------	--------	-------------

② 期末自己株式数

24年3月期2Q	— 株	23年3月期	— 株
----------	-----	--------	-----

③ 期中平均株式数(四半期累計)

24年3月期2Q	9,282,500 株	23年3月期2Q	7,680,000 株
----------	-------------	----------	-------------

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】P.3「(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

(参考) 平成24年3月期の個別業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、通期は対前期増減率)

	売上高		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通 期	19,200	5.8	2,050	△47.1	1,270	△66.6	136.82

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

## ○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報 .....	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報 .....	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報 .....	3
2. サマリー情報（その他）に関する事項 .....	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 .....	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 .....	3
3. 四半期連結財務諸表 .....	4
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	4
(2) 四半期連結損益及び包括利益計算書 .....	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....	7
(4) 継続企業の前提に関する注記 .....	8
(5) セグメント情報等 .....	8
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....	9
(7) 重要な後発事象 .....	9

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間（以下、「当累計期間」という。）における経済状況は、東日本大震災の復興需要に伴う一部商品の生産増加があったものの、電力不足に伴う節電による生産効率の低下や、円高の継続、欧州の財政危機などにより、企業業績は低迷いたしました。

当社グループの属する半導体業界は、昨年から継続していたスマートフォンなどの需要の伸びが緩やかになったことを受け、今年度に入りセットメーカーの在庫が増加したことに伴い、年初の強気の生産計画を見直す動きが出てまいりました。

このような状況の下、当社グループのテスト受託状況は、第1四半期連結会計期間には予想していた東日本大震災の影響もほとんど無く、堅調に推移いたしました。当第2四半期連結会計期間（以下、「当会計期間」という。）には最終製品の市場環境の悪化に伴い、メモリ事業、システムLSI事業とも受託が減少傾向となりました。

この結果、当累計期間における当社グループの売上高は11,279百万円（前年同期比10.3%増）、営業利益は1,848百万円（同23.4%減）、経常利益1,683百万円（同25.5%減）、四半期純利益974百万円（同39.1%減）となりました。

セグメント別の業績は以下のとおりであります。なお、セグメント別の業績には連結調整額、為替換算レート調整額、セグメント別に配分されない費用を含んでおりません。

#### ① メモリ事業

メモリ事業においては、当会計期間には、主要顧客の生産品のうちテスト装置をより長時間稼動する必要のある製品（以下、「テスト時間の長い製品」という。）の生産数量が減少いたしました。当累計期間全体では、前連結会計年度の第2四半期連結累計期間に比べ、テスト時間の長い製品の割合が増加したことなどにより、売上高は10,253百万円（前年同期比9.5%増）となりました。しかし、前連結会計年度に、テスト時間の長い製品の増加に対応するため、テスト装置への積極的な設備投資を行ったことにより、減価償却費が1,133百万円（同54.2%増）増加したことなどから、セグメント利益は2,774百万円（同17.3%減）となりました。

#### ② システムLSI事業

システムLSI事業においては、当累計期間は前連結会計年度の第2四半期連結累計期間に比べ、イメージセンサ、アナログなどの受託量が増加したことなどにより、売上高は1,048百万円（前年同期比20.9%増）、セグメント損益は360百万円の損失（前年同期は437百万円の損失）となりました。

### (2) 連結財政状態に関する定性的情報

#### ① 資産、負債及び純資産の状況

当会計期間末における総資産は47,424百万円となり、前連結会計年度末比2,901百万円の減少となりました。これは主に、前連結会計年度に取得した設備代金の支払いが当累計期間に生じたことで現金及び預金が2,003百万円減少したこと、未収入金が902百万円減少したことによるものです。

負債は20,182百万円となり、前連結会計年度末比3,585百万円の減少となりました。これは主に、設備購入代金の支払等により未払金が2,176百万円減少したこと及び返済によりリース債務が754百万円減少したことによるものです。

純資産は27,241百万円となり、前連結会計年度末比684百万円の増加となりました。これは主に、四半期純利益の計上により利益剰余金が974百万円増加したことによるものです。

#### ② キャッシュ・フローの状況

当会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は5,207百万円となり、前連結会計年度末比2,003百万円の減少となりました。

当累計期間のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

##### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、当累計期間での税金等調整前四半期純利益1,759百万円及び減価償却費4,341百万円の計上を主体とした資金の増加に対し、法人税等の支払915百万円を主体とした資金の減少により5,252百万円の純収入（前年同期比20.4%の収入増）となりました。

##### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、6,992百万円の純支出（前年同期比218.1%の支出増）となりました。これは主に、有形固定資産の取得によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、218百万円の純支出（前年同期比90.2%の支出減）となりました。これは主に、セール・アンド・リースバック取引による3,166百万円の収入と、リース債務の返済による3,234百万円の支出によるものです。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

当連結会計年度の業績予想につきましては、期初に発表いたしました業績見通しにおいてメモリ事業、システムLSI事業とも順調に推移するものと予想しておりましたが、市場環境の変化等により、以下のように修正しております。

メモリ事業におきましては、スマートフォンなどのモバイル製品について期初予想ほど需要が伸びなかったため、テスト需要が伸び悩みました。また、DRAMの需要が低迷し、市場価格が大きく下がる中、DRAMメーカーによる生産調整などが行われ、テスト需要についても減少傾向となっております。

システムLSI事業におきましても、デジタル家電の需要が低迷していることや、スマートフォン、携帯電話の在庫調整などによりテスト需要は低迷しております。

一方、平成23年10月1日から、携帯機器向けに有効な半導体パッケージであるウエハレベルパッケージ(WLP)の受託生産を行う株式会社テラミクロスを連結子会社に加えることで、新たに当該ビジネスの収益が加わる予定であります。

以上のようにテスト受託の売上低迷が予想される中、経費削減等の施策を実施してまいりますが、売上高減少の影響を補うことは難しく、当連結会計年度の業績予想は、売上高25,300百万円、営業利益2,900百万円、経常利益2,500百万円、当期純利益1,400百万円と変更いたしております。なお、株式会社テラミクロス買収に伴うのれんの影響は織り込んでいないため、今後変更が生じる可能性があります。

詳細につきましては、本日（平成23年10月26日）公表の「通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

(参考)

上記理由により個別業績予想についても以下のように修正しております。

当会計年度の売上高は19,200百万円、経常利益は2,050百万円、当期純利益は1,270百万円と変更しております。

## 2. サマリー情報（その他）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	7,211,189	5,207,988
受取手形及び売掛金	3,774,836	3,305,270
製品	12,675	19,805
仕掛品	139,692	192,214
貯蔵品	24,263	27,026
未収入金	3,293,869	2,391,780
その他	242,405	304,845
流動資産合計	14,698,932	11,448,930
固定資産		
有形固定資産		
機械装置及び運搬具（純額）	27,037,352	27,580,248
その他（純額）	7,219,071	7,157,581
有形固定資産合計	34,256,423	34,737,830
無形固定資産	490,844	458,405
投資その他の資産	879,134	779,008
固定資産合計	35,626,402	35,975,244
資産合計	50,325,335	47,424,174
負債の部		
流動負債		
買掛金	479,490	611,439
短期借入金	1,580,400	1,412,218
1年内返済予定の長期借入金	300,000	300,000
リース債務	5,994,960	5,067,581
未払金	5,131,497	2,954,815
未払法人税等	992,098	712,263
引当金	338,135	250,084
その他	699,981	659,908
流動負債合計	15,516,563	11,968,312
固定負債		
長期借入金	300,000	150,000
リース債務	7,622,040	7,794,664
引当金	146,118	167,045
その他	182,953	102,260
固定負債合計	8,251,112	8,213,970
負債合計	23,767,675	20,182,282

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	11,823,312	11,823,312
資本剰余金	11,380,267	11,380,267
利益剰余金	1,972,117	2,946,915
株主資本合計	25,175,698	26,150,495
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	△281,920	△478,318
その他の包括利益累計額合計	△281,920	△478,318
少数株主持分	1,663,881	1,569,715
純資産合計	26,557,660	27,241,892
負債純資産合計	50,325,335	47,424,174

(2) 四半期連結損益及び包括利益計算書  
(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
売上高	10,224,136	11,279,693
売上原価	7,004,358	8,533,174
売上総利益	3,219,778	2,746,518
販売費及び一般管理費	※ 805,705	※ 897,590
営業利益	2,414,073	1,848,927
営業外収益		
受取利息	1,406	2,761
設備賃貸料	21,598	19,045
受取手数料	9,114	—
受取補償金	—	58,036
その他	2,773	8,871
営業外収益合計	34,892	88,714
営業外費用		
支払利息	112,730	123,699
休止固定資産減価償却費	36,285	58,202
支払補償費	—	58,283
その他	40,526	13,940
営業外費用合計	189,543	254,126
経常利益	2,259,422	1,683,515
特別利益		
固定資産売却益	112,999	105,822
特別利益合計	112,999	105,822
特別損失		
固定資産売却損	57,271	3,653
固定資産除却損	5,959	26,426
ノウハウライセンス契約解約損	38,095	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	2,453	—
特別損失合計	103,779	30,080
税金等調整前四半期純利益	2,268,642	1,759,258
法人税等	465,301	689,931
少数株主損益調整前四半期純利益	1,803,340	1,069,326
少数株主利益	202,289	94,529
四半期純利益	1,601,051	974,797
少数株主利益	202,289	94,529
少数株主損益調整前四半期純利益	1,803,340	1,069,326
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	△253,598	△385,094
その他の包括利益合計	△253,598	△385,094
四半期包括利益	1,549,742	684,232
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,471,716	778,398
少数株主に係る四半期包括利益	78,025	△94,166

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	2,268,642	1,759,258
減価償却費	3,157,748	4,341,845
受取利息	△1,406	△2,761
支払利息	112,730	123,699
受取補償金	—	△58,036
固定資産除売却損益 (△は益)	△49,769	△75,742
ノウハウライセンス契約解約損	38,095	—
支払補償費	—	58,283
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	2,453	—
設備賃貸料	△21,598	△19,045
売上債権の増減額 (△は増加)	△792,811	390,354
たな卸資産の増減額 (△は増加)	33,497	△66,687
仕入債務の増減額 (△は減少)	86,747	134,325
引当金の増減額 (△は減少)	36,802	△56,872
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	4,252	△70,288
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△302,104	△155,362
その他	△10,777	△13,056
小計	4,562,503	6,289,914
利息の受取額	4,974	2,757
利息の支払額	△112,730	△124,049
補償金の受取額	—	58,036
損害賠償金の支払額	—	△58,283
法人税等の還付額	8,940	—
法人税等の支払額	△100,266	△915,702
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,363,420	5,252,673
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△2,722,593	△7,178,698
有形固定資産の売却による収入	465,200	225,361
無形固定資産の取得による支出	△17,046	△51,656
設備賃貸料の受取額	81,604	19,920
資産除去債務の履行による支出	—	△3,800
その他	△5,193	△3,935
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,198,029	△6,992,808
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入れによる収入	991,302	—
長期借入金の返済による支出	△150,000	△150,000
リース債務の返済による支出	△3,536,638	△3,234,492
セール・アンド・リースバック取引による収入	462,560	3,166,154
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,232,775	△218,337
現金及び現金同等物に係る換算差額	△40,221	△44,727
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△107,606	△2,003,201
現金及び現金同等物の期首残高	2,820,690	7,211,189
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 2,713,084	※ 5,207,988

## (4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

## (5) セグメント情報等

## I 前第2四半期連結累計期間(自平成22年4月1日至平成22年9月30日)

## 1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			調整額 (注1)	合計 (注2)
	メモリ事業	システム LSI事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	9,361,528	867,175	10,228,703	△4,566	10,224,136
セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	-	-	-	-
計	9,361,528	867,175	10,228,703	△4,566	10,224,136
セグメント利益又は 損失(△)	3,355,706	△437,645	2,918,061	△503,988	2,414,073

(注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額△503,988千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△495,359千円、連結消去△7,144千円、円換算に用いた為替相場の相違による差異調整額△1,484千円であります。

全社費用は、主に報告セグメントに属していない一般管理費です。

2. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。

## 2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

## II 当第2四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)

## 1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			調整額 (注1)	合計 (注2)
	メモリ事業	システム LSI事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	10,253,277	1,048,605	11,301,883	△22,189	11,279,693
セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	-	-	-	-
計	10,253,277	1,048,605	11,301,883	△22,189	11,279,693
セグメント利益又は 損失(△)	2,774,932	△360,361	2,414,570	△565,642	1,848,927

(注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額△565,642千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△579,069千円、連結消去17,797千円、円換算に用いた為替相場の相違による差異調整額△4,371千円であります。

全社費用は、主に報告セグメントに属していない一般管理費です。

2. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。

## 2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記  
該当事項はありません。

(7) 重要な後発事象

(株式の新規取得による子会社化及び子会社の増資引受けについて)

当社は平成23年6月17日開催の取締役会決議に基づき、株式会社テラミクロスの株式をカシオ計算機株式会社より平成23年10月1日に取得し、子会社化いたしました。

1. 株式取得の目的

当社は、ウエハレベルパッケージ（WLP）関連事業を取得することで、新たな成長戦略ドメインのひとつとしてウエハテスト受託事業とのシナジー効果が期待される、ターンキービジネス領域の強化・拡大を図ることを目的としております。

2. 株式を取得する会社の概要

(1) 商号

株式会社テラミクロス

(2) 代表者

越丸 茂（当社 代表取締役会長）

(3) 所在地

東京都青梅市

(4) 規模

資本金 500千円

3. 事業内容

WLP等の研究、開発、設計、製造及びその販売

4. 取得する株式の数、取得価額および取得後の所有割合

(1) 取得した株式の数

1株

(2) 取得価額

600,000千円

(3) 取得後の所有割合

100%

5. 株式の取得日

平成23年10月1日

6. 支払資金の調達方法

自己資金

7. 子会社増資について

当社は、平成23年9月28日開催の取締役会において、株式会社テラミクロスの第三者割当増資を全額引き受けることを決議し、平成23年10月3日に払込を完了いたしました。

(1) 増資の目的

株式会社テラミクロスの財務体質の強化を図るため。

(2) 増資の概要

①増資金額 300,000千円

②払込期日 平成23年10月3日

③割当先 当社100%

④資本金（増資後） 300,500千円